



# 第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

**演讲题目:** 功率器件封装材料和工艺现状及研究进展

**演讲人:** 徐菊 博士 华为 2012 实验室

**演讲摘要:**

**演讲大纲:**

**适合对象:**

**演讲人简介:**

徐菊，博士，2023 年加入华为技术有限公司 2012 实验室，为单板技术部板级工艺技术 20 级专家，入职前先后在爱尔兰 tyndall 国家微电子研究所，美国乔治亚理工学院机械系及电子封装中心，中国科学院电工研究所微纳加工实验室从事电子封装材料、工艺和新型检测技术、热管理材料及热功能材料及器件方向的研究。曾获得过中科院百人计划 A 类人才，英国皇家学会高级牛顿学者，欧盟玛丽居里研究学者。